

电子

周跟踪 (20241125-20241129)

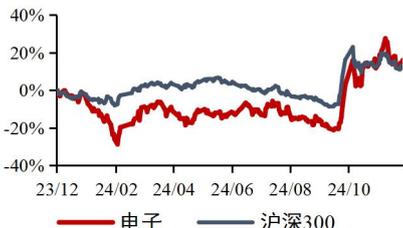
领先大市-A(维持)

华为 Mate 70 系列发布, 24Q3 全球晶圆代工行业收入同比增长 27%

2024 年 12 月 2 日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源: 最闻

相关报告:

【山证电子】Rokid 发布新款 AI 眼镜, 美升级对华科技发展的限制措施-山西证券电子行业周跟踪 2024.11.25

【山证电子】百度发布首款 AI 眼镜, 先进制程对国内供应趋严-山西证券电子行业周跟踪 2024.11.18

分析师:

高宇洋

执业登记编码: S0760523050002

邮箱: gaoyuyang@sxzq.com

研究助理:

董雯丹

邮箱: dongwendan@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体:** 本周(2024.11.25-11.29)市场大盘整体上涨, 上证指数涨 1.81%, 深圳成指涨 1.66%, 创业板指涨 2.23%, 科创 50 涨 3.92%, 申万电子指数涨 2.38%, Wind 半导体指数涨 3.67%。外围市场, 费城半导体指数跌 0.59%, 台湾半导体指数跌 4.00%。细分板块中, 周涨跌幅前三为**数字芯片设计(+5.03%)**、**半导体(+3.25%)**、**电子化学品(+2.75%)**。从个股看, 涨幅前五为**贝仕达克(+80.19%)**、**康冠科技(+29.08%)**、**方正科技(+28.61%)**、**睿能科技(+26.79%)**和**鑫汇科(+23.00%)**; 跌幅前五为: **远望谷(-21.26%)**、***ST 合泰(-18.89%)**、和**而泰(-17.70%)**、**国光电器(-17.19%)**和**福日电子(-13.89%)**。

➢ **行业新闻:** 华为 Mate 70 系列正式发布, 性能较前代提升 40%。华为 Mate 70 以“真 AI”为核心亮点, 首发 AI 手势控制功能, 并搭载 AI 运动轨迹特效、AI 智控键等九大智慧功能, 全面提升用户操作体验。该系列搭载 Harmony OS NEXT 系统, 同时支持用户自由选择升级原生系统或继续使用鸿蒙 4.3 系统。此外, 产品还配备超聚光潜距长焦镜头、端侧计算力和云端算力双大模型加持, 进一步优化影像能力和算力表现, 展示华为在旗舰机市场的创新实力。台积电 2027 年推出超大版 CoWoS 封装, 可放置 12 个 HBM4 堆栈。台积电在欧洲开放创新平台(OIP)论坛上宣布, 预计 2027 年认证超大版本的 CoWoS 封装技术, 支持高达 9 个掩模尺寸的中介层和 12 个 HBM4 内存堆栈, 专为超高端 AI 和 HPC 处理器设计, 适配 1.6nm 与 2nm 芯片垂直堆叠, 实现高晶体管密度。2024 年第三季度, 全球晶圆代工行业营收同比增长 27%, 环比增长 11%。全球晶圆代工行业营收增长主要受 AI 需求强劲和中国市场快速复苏推动。以台积电 N3 和 N5 为代表的先进制程需求增长显著, 非 AI 半导体市场复苏较缓。中国代工厂商如中芯国际和华虹的产能利用率提升至 90%以上, 得益于本地客户需求复苏和半导体本地化政策, 但成熟制程竞争预计在 2025 年加剧。台积电行业营收份额提升至 64%, 其 AI 相关收入占比持续扩大, 尽管计划大幅扩增 CoWoS 产能, 仍难满足市场需求。非 AI 半导体市场预计 2025 年逐步复苏, 缓解行业周期见顶的担忧。

➢ **重要公告:** 【华海诚科】拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买杭州曙辉等 13 名股东持有的衡所华威 70% 股权并募集配套资金。【光弘科技】计划向特定对象发行股票, 募集资金不超过 10.33 亿元, 用于收购法国 AC 公司 100% 股权及其子公司 TIS 工厂部分股权, 以及补充流动资金, 以实现汽车电子领域的业务扩展和全球化产业布局。【泰凌微】拟向激励对象授予 439 万股限制性股票和 41 万份股票增值权。激励对象总人数为 105 人, 激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员。

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明

1





投资建议

➤ 四季度作为消费电子旺季，随着以华为 Mate70 为代表的消费电子产品密集发布，AI 端侧应用加速，赋能眼镜、耳机、手表/手环等可穿戴设备，以及政策补贴 3C 产品的确定性趋势，我们认为消费电子将迎来换机潮并推动相关供应链备货。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及 AI 端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。

风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。

目录

1. 行情回顾.....	5
1.1 市场整体行情.....	5
1.2 细分板块行情.....	5
1.2.1 涨跌幅.....	5
1.2.2 估值.....	6
1.3 个股公司行情.....	7
2. 数据跟踪.....	7
3. 新闻公告.....	10
3.1 重大事项.....	10
3.2 行业新闻.....	11
4. 风险提示.....	12

图表目录

图 1： 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	5
图 2： 周涨跌幅数字芯片设计、半导体、电子化学品领先.....	5
图 3： 月涨跌幅半导体设备、半导体材料、半导体表现领先（30 日滚动）.....	6
图 4： 年初至今半导体设备、数字芯片设计、半导体表现领先.....	6
图 5： 多数板块当前 P/E 高于历史平均值.....	6
图 6： 多数板块当前 P/B 处于历史平均值附近.....	6
图 7： 本周个股涨幅前五.....	7
图 8： 本周个股跌幅前五.....	7
图 9： 全球半导体月度销售额及增速.....	7



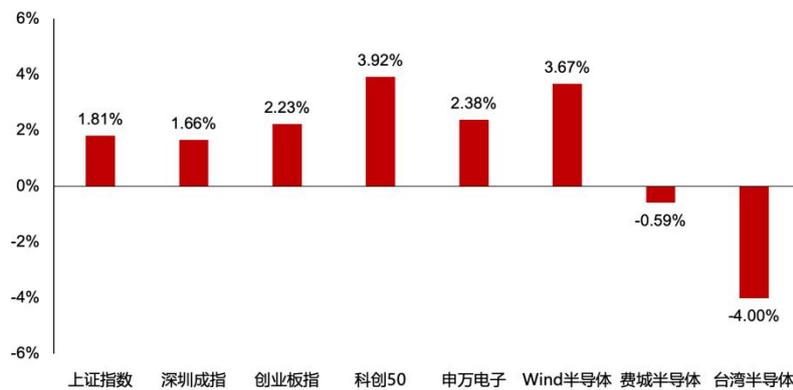
图 10: 分地区半导体销售额.....	7
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	8
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	8
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	8
图 14: 北美半导体设备销售额.....	8
图 15: 日本半导体设备销售额.....	8
图 16: 全球硅片出货面积.....	8
图 17: NAND 现货平均价.....	9
图 18: DRAM 现货均价.....	9
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	9
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	9
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	9
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	10
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	10
表 1: 本周重大事项.....	10
表 2: 本周重要行业新闻.....	11

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2024.11.25-11.29）市场大盘整体上涨，上证指数涨 1.81%，深圳成指涨 1.66%，创业板指涨 2.23%，科创 50 涨 3.92%，申万电子指数涨 2.38%，Wind 半导体指数涨 3.67%。外围市场，费城半导体指数跌 0.59%，台湾半导体指数跌 4.00%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

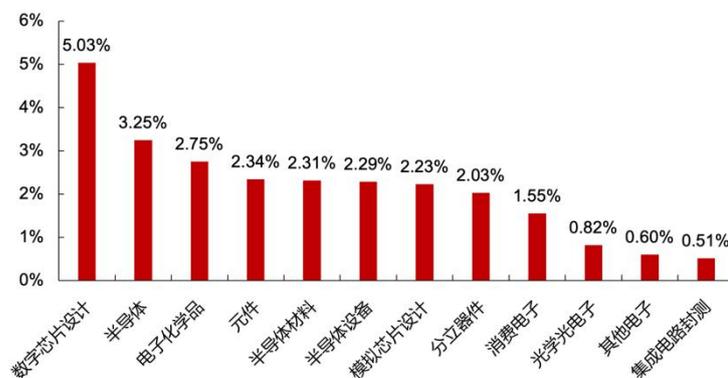


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

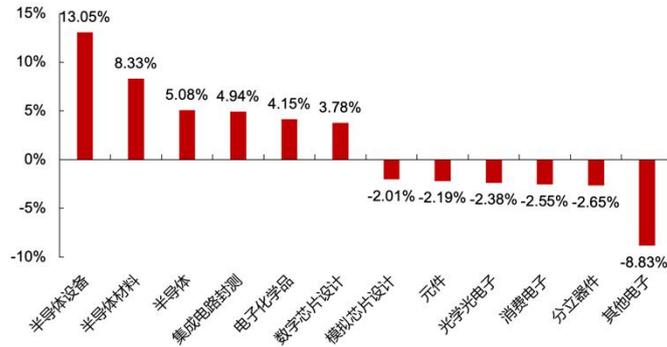
1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅数字芯片设计、半导体、电子化学品领先



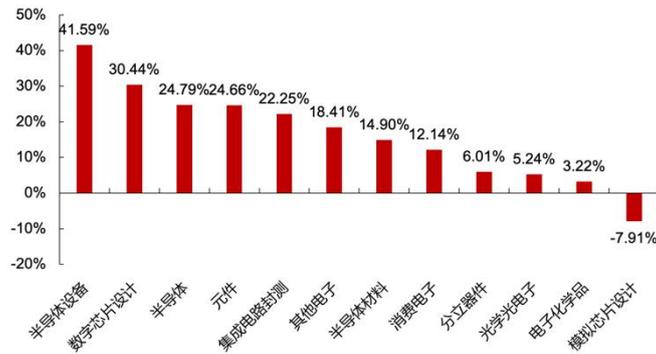
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 3：月涨跌幅半导体设备、半导体材料、半导体表现领先（30 日滚动）



资料来源：Wind，山西证券研究所

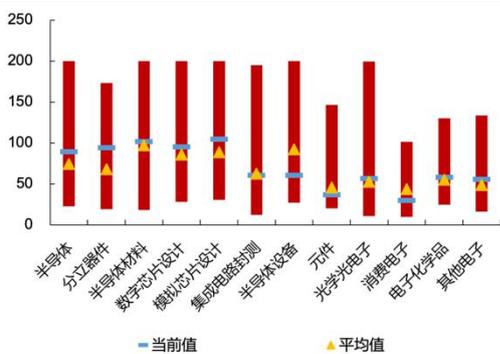
图 4：年初至今半导体设备、数字芯片设计、半导体表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

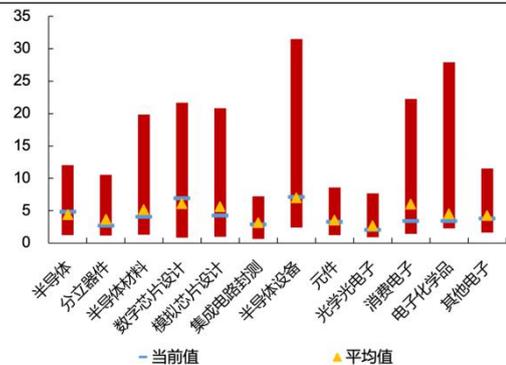
1.2.2 估值

图 5：多数板块当前 P/E 高于历史平均值



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 处于历史平均值附近

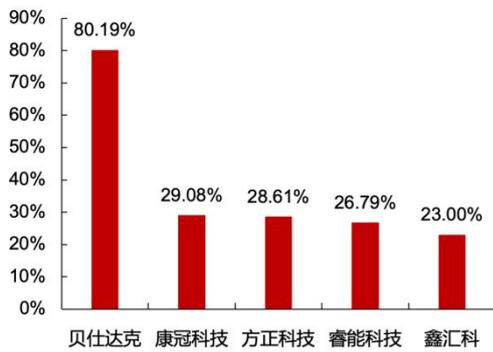


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

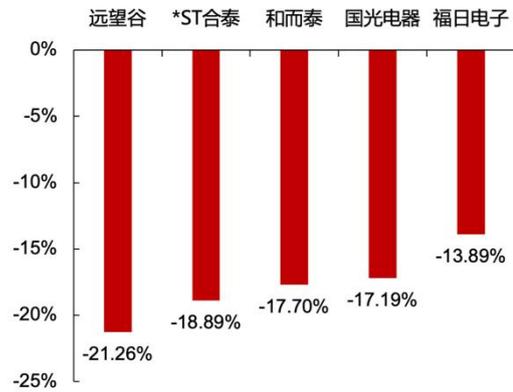
从个股情况看，贝仕达克、康冠科技、方正科技、睿能科技和鑫汇科涨幅领先，涨幅分别为 80.19%、29.08%、28.61%、26.79%和 23.00%；远望谷、*ST 合泰、和而泰、国光电器和福日电子跌幅居前，跌幅分别为 21.26%、18.89%、17.70%、17.19%和 13.89%

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

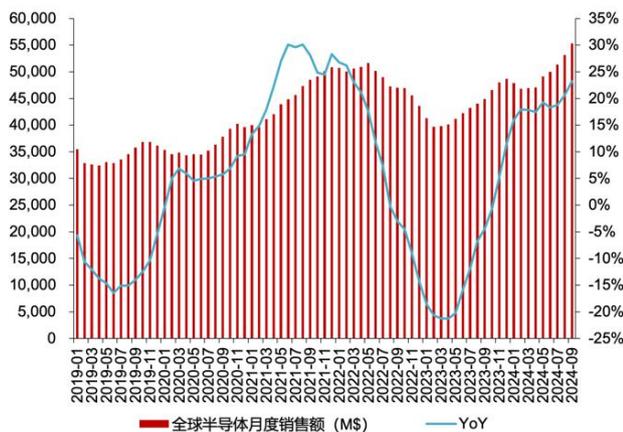
图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

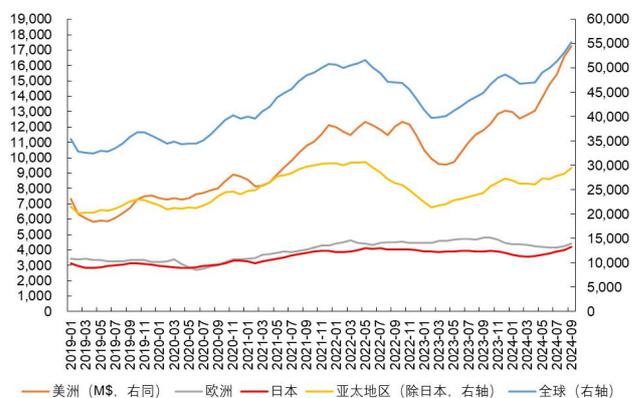
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



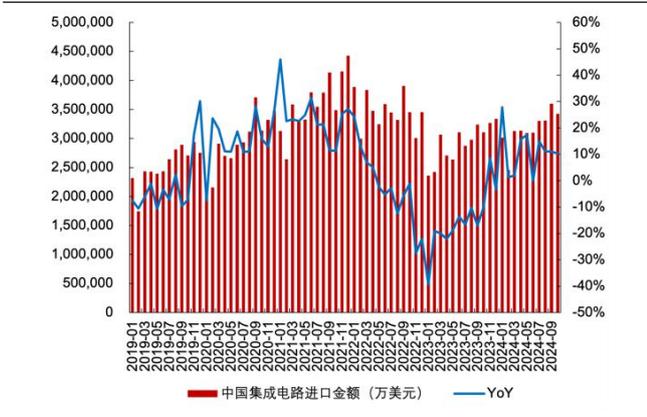
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 10：分地区半导体销售额



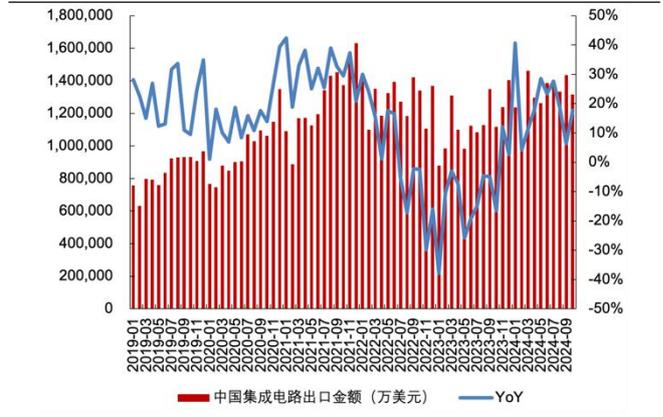
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 11：中国集成电路行业进口情况



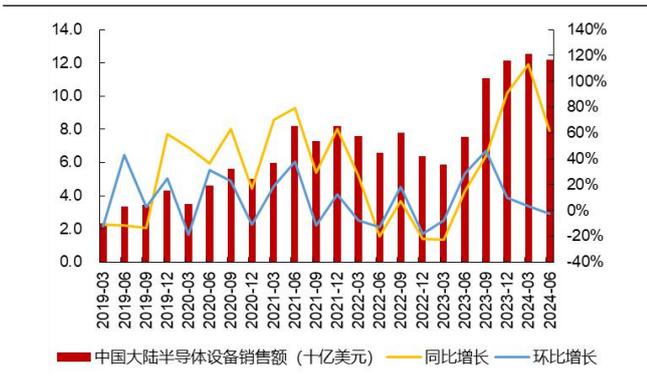
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 12：中国集成电路行业出口情况



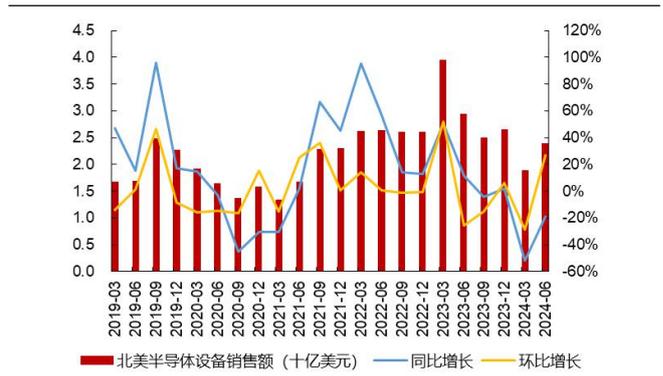
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 13：中国大陆半导体设备销售额



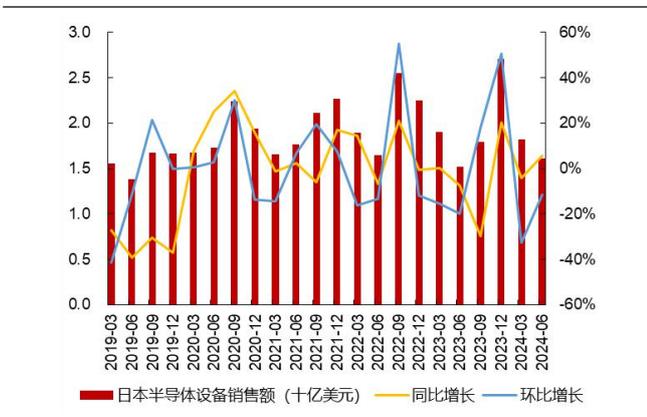
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 14：北美半导体设备销售额



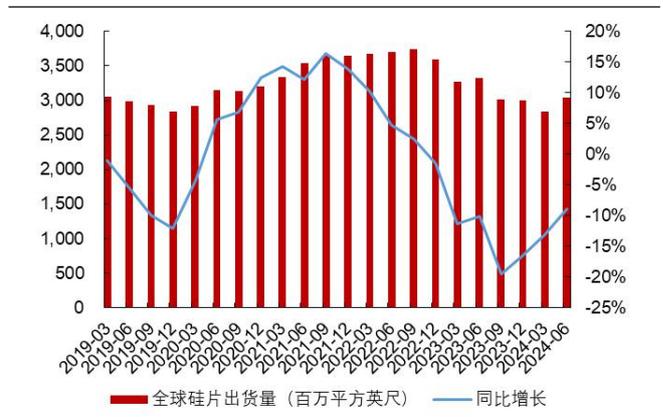
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 15：日本半导体设备销售额



资料来源：Wind，山西证券研究所

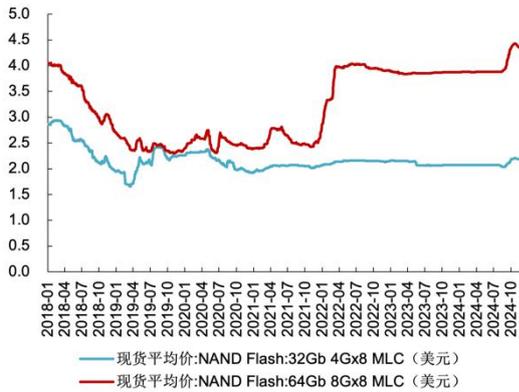
图 16：全球硅片出货面积



资料来源：SEMI，山西证券研究所

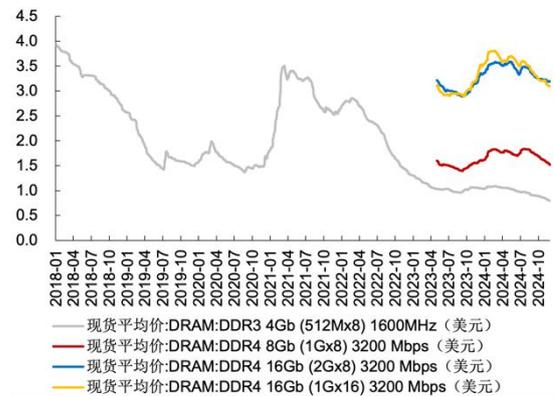


图 17: NAND 现货均价



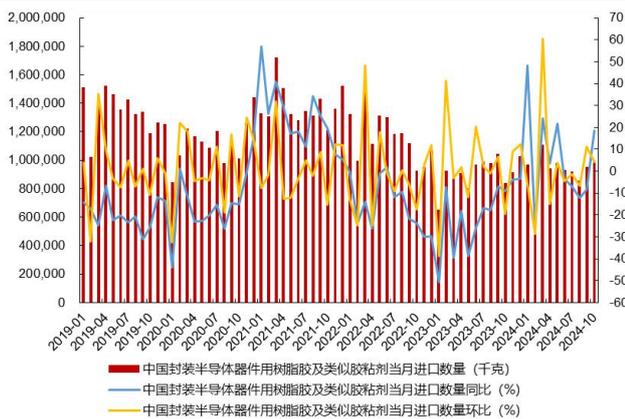
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



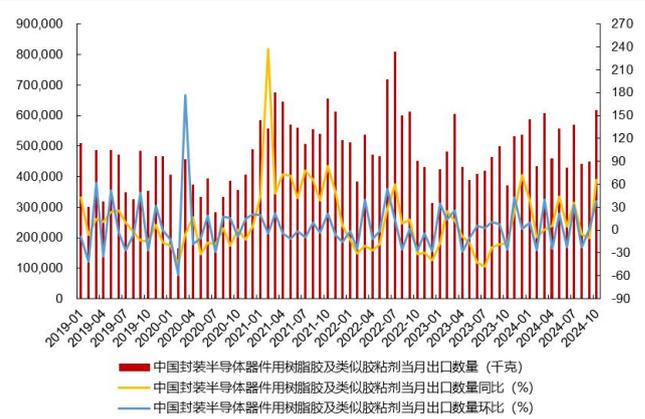
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



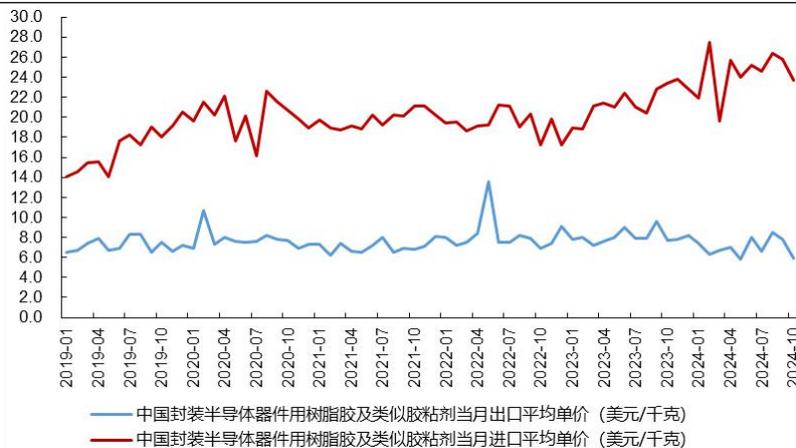
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



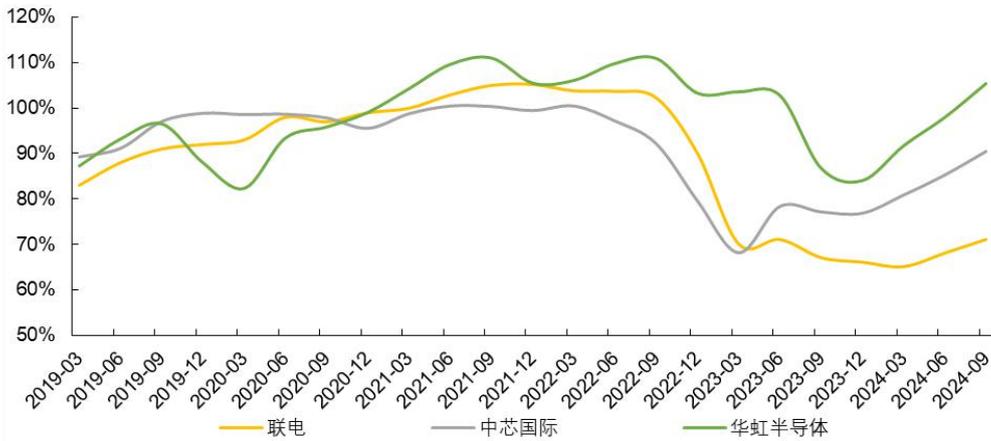
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 21: 半导体封装材料进出口均价



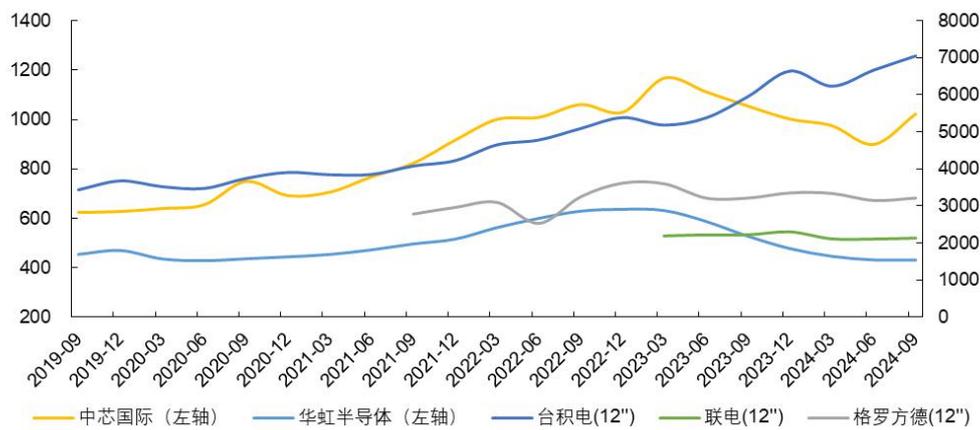
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 22：晶圆厂稼动率（%）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 1：本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024 年 11 月 25 日		易天股份、晶升股份			
2024 年 11 月 26 日		飞荣达、云里物里	华海诚科	华海诚科	华海诚科、光弘科技
2024 年 11 月 27 日		中科飞测、永新光学			

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024年11月28日		昀冢科技、蓝箭电子			
2024年11月29日		奥比中光-UW	凌云光、万润股份		
2024年11月30日		中船特气、富创精密	恒烁股份		伟时电子

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2024年11月25日	预计 2025 年全球笔电出货量将增长 4.9%，商务需求成新亮点。 根据 TrendForce 集邦咨询调查，2024 年全球笔记本电脑出货量预计为 1.74 亿台，年增 3.9%，受高利率和地缘因素影响，需求回温缓慢；2025 年受美国大选落幕、降息启动、Windows 10 终止服务及商务换机需求等因素刺激，出货量预计年增 4.9%至 1.83 亿台。商务笔电 2024 年受经济环境影响需求保守，2025 年预计回升超 7%；消费笔电 2024 年入门款机种需求强劲，2025 年增速放缓至 3%，但产品结构更优化。Chromebook 在 2024 年表现稳定，2025 年受日本 GIGA School 2.0 计划推动，年增 8%。目前，中国仍是全球笔记型电脑的主要生产地，其产能约占全球的 89%。尽管部分产能向越南、泰国等地转移，但供应链生态完善仍需时间，2025 年出货预测仍可能调整。	Trendforce
2024年11月26日	台积电高雄 2 纳米厂举行装机仪式 苹果、AMD 可望是首批客户。 台积电高雄 2 纳米厂 11 月 26 日举行设备进机仪式该厂比预期早逾半年进机，预料苹果、AMD 等大厂都将是首批客户。据了解，台积电今天高雄厂 2 奈纳新厂进机典礼公司定义为“内部不对外公开活动”，公司公关窗口昨（25）日对相关议题三缄其口，保密到家。台积电在台布局 2 奈米，新竹宝山、高雄新厂两路并进，预计 2025 年量产。。	金融界
2024年11月26日	华为 Mate 70 系列正式发布，性能较前代提升 40%。 华为 Mate 70 以“真 AI”为核心亮点，首发 AI 手势控制功能，并搭载 AI 运动轨迹特效、AI 智控键等九大智慧功能，全面提升用户操作体验。该系列搭载 Harmony OS NEXT 系统，同时支持用户自由选择升级原生系统或继续使用鸿蒙 4.3 系统。此外，产品还配备超聚光潜距长焦镜头、端侧计算力和云端算力双大模型加持，进一步优化影像能力和算力表现，展示华为在旗舰机市场的创新实力。	财联社
2024年11月28日	台积电 2027 年推出超大版 CoWoS 封装，可放置 12 个 HBM4 堆栈。 台积电在欧洲开放创新平台（OIP）论坛上宣布，预计 2027 年认证超大版本的 CoWoS 封装技术，支持高达 9 个掩模尺寸的中介层和 12 个 HBM4 内存堆栈，专为超高端 AI 和 HPC 处理器设计，适配 1.6nm 与 2nm 芯片垂直堆叠，实现高晶体管密度。然而，超大 CoWoS 封装需基板尺寸超过 120x120 毫米，对系统设计、电源与冷却提出严苛要求，包括每机架数百千瓦功率及液体冷却等管理方式。	SEMI 大半导体产业网
2024年11月28日	2024 年第三季度，全球晶圆代工行业营收同比增长 27%，环比增长 11%，主要受 AI 需求强劲和中国市场快速复苏推动。 以台积电 N3 和 N5 为代表的先进制程需求增长显著，非 AI 半导体市场复苏较缓。中国代工厂商如中芯国际和华虹的产能利用率提升至 90%以上，得益于本地客户需求复苏和半导体本地化政策，但成熟制程	Counterpoint



时间	内容	来源
	竞争预计在 2025 年加剧。台积电行业营收份额提升至 64%，其 AI 相关收入占比持续扩大，尽管计划大幅扩增 CoWoS 产能，仍难满足市场需求。非 AI 半导体市场预计 2025 年逐步复苏，缓解行业周期见顶的担忧。	
2024 年 11 月 29 日	铠侠 12 月或将减产 NAND 报价有望止跌或反转。 据报道，铠侠计划于 2024 年 12 月进行减产，预计将有助于 NAND Flash 报价止跌或反转，服务器需求仍将支撑市场需求。TrendForce 指出，NAND Flash 第四季度面临挑战，消费类产品合约价已下跌，品牌商年底前降库存导致订单减弱。尽管短期内受大陆模组厂抛售影响，现货价和合约价将逐季下降 5-10%，但 2025 年 NAND Flash 市场在原厂减产效应，AI SERVER、通用型 SERVER 大容量 eSSD 需求维持强劲下，待终端消费型产品需求回温，预期整体 NAND Flash 市场将恢复供需平衡。	工商时报

资料来源：Trendforce，金融界，财联社，SEMI 大半导体产业网，Counterpoint，工商时报，山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：

——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区金田路 3086 号大百汇广场 43 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

